

性能特点

- 低沉降
- 优越的耐高低温、耐高湿性、耐气候性
- 适于丝网印刷、自动点胶等工艺
- 有一定触变性

产品描述

PAKCOOL® TG-235-CB 导热硅脂是用于电子装置中的导热材料。本产品具有较高的导热性，可使需冷却的电子元件表面和散热器之间紧密接触、减小热阻，可快速有效地降低电子原件的温度，从而延长电子元件的使用寿命并提高其可靠性。

在使用时，本产品需要一定压力使其流动并填充入缝隙中；在无压力作用下，不会任意流动，不产生应力。本产品不会交联，便于在电子装配过程中需要改动或更换散热器情况时操作。

典型应用

- 功率模块
- 集成芯片
- 电源模块
- 车用电子产品
- 激光设备
- LED 照明
- 通讯设备
- 计算机及其附件

注意事项

- 如客户需要更详细的说明，请与我公司市场销售部联系。他们会随时为您解答和服务。

技术参数

| 特性 | TG-235-CB | 测试方法 |
|-------------------------|-----------|---------------|
| 外观 | 白色膏状 | -- |
| 粘度 (cP) | 25 万±8 万 | ASTM D2196-15 |
| 导热系数 (W/m·K) | 3.5 | ASTM D5470 |
| 密度 (g/cm ³) | 3.30±0.30 | ASTM D792 |
| 挥发物 (% @150°C×3hrs) | ≤0.35 | GB 33372-2020 |
| 阻燃 | V-0 | UL 94 |
| 连续使用温度 (°C) | -50~+200 | -- |

本数据仅可用于指导，并不可用于作为产品规范。

使用方法

- 被涂器件材质如果吸油性很大，会使胶料状态有明显变厚变干的现象。故需表面处理为不吸油的器件，或用我司单组份胶表面涂抹以进行防吸油处理。器件材质不吸油的判断一般以常温涂上胶料 24 小时后状态无明显变化即可。
- 清洁涂覆件表面，将足够量的本产品挤出或抹到器件表面，再将两表面施压贴合即可。如有挤出的硅脂可用布擦净。每次用完应密封以备后用。

包装储运

- 本产品可提供 55mL 点胶针筒，330mL 胶瓶，1Kg 罐装，5Kg 和 20Kg 的桶装，或根据客户要求定制包装。
- 本产品为无毒、不燃材料，室温下的储存期约 12 个月。如有在储藏期间有渗油出现，应将其搅拌均匀后使用；支装产品由于无法搅拌，应水平停放，尽量在 1 个月内使用，不宜超过 3 个月。同时低温存储（< 0°C）有助于改善渗油，根据支装的大小用前在使用环境回温 2 小时-8 小时或以上即可使用。
- 可以作为一般液体化学品运输。

本说明书的数据是实验室条件下获得。但因为使用环境、工艺等差异，所以不能保证产品在某些用法与用途上的正确性和适用性。用户在使用时，一定要先进行测试，以确认适合您使用目的的产品。如您在使用本产品中出现任何问题，欢迎和我司技术部门联系，我们将尽力为您提供帮助。